

IC 引き抜き治具 IC Package Extraction Tool

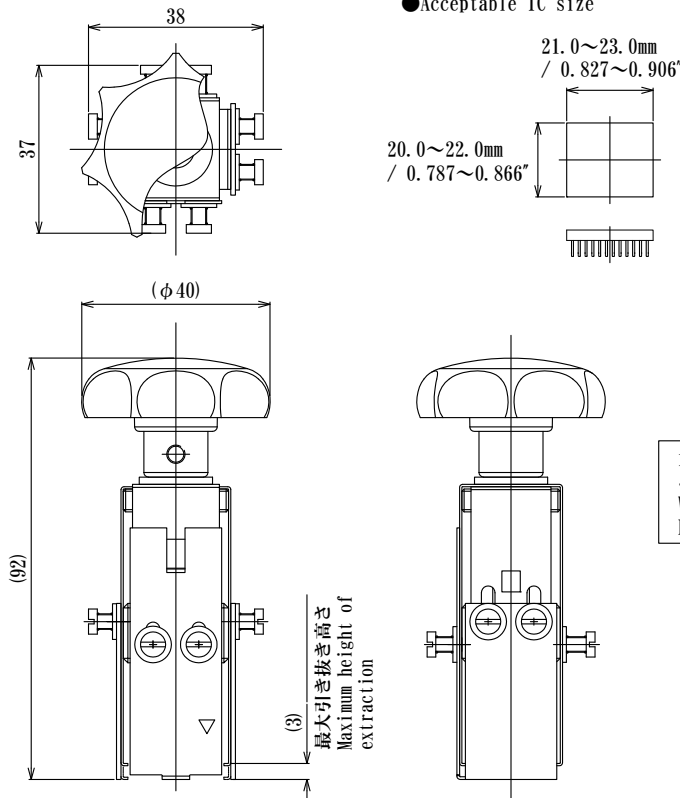
PGA、SIP、DIP型ICを、IC Socketから
引き抜くことを目的とした治具です。
Extraction tool for PGA, SIP and DIP type IC package.

特徴 Features

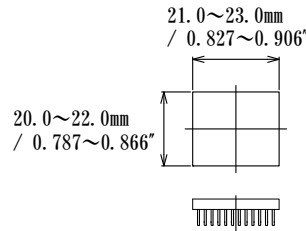
- IC SocketからICを簡単に引き抜くことができます。
Easy extraction of IC package from IC socket.
- 垂直にICを引き抜けるため、ICのリドを曲げる事はありません。
Vertical extraction prevents IC leads bending
- 挿抜力が高いときに最適です。
Suitable for need of high extraction force.

PGA型IC対応タイプ
For PGA type IC Package.

PGA-NJG-TS4-3738-L92 (example)



●Acceptable IC size



貴社の特注仕様にて設計製作できますので、
お問合せください。
We handle custom-made extraction tool.
Please feel free to contact us for more details.

How to use

